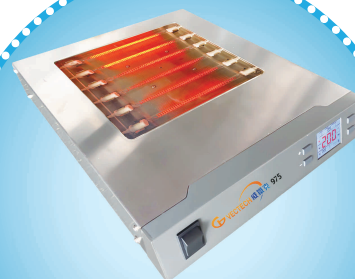




BGA500P 熱風式 BGA 返修設備



另 購



975 IR 熱輻射預熱台
(具有分區加熱功能)

另 購



800A 熱風握柄升降台
PCB 板固定架

特 點

- 上部加熱器，具有 CH0~CH9，10 組可記憶的工作程式，每組工作程式設有 6 個工作段的溫度、時間、風量。
- 視窗可查看設定的每個工作階段的溫度、時間、風量等參數資料，拆焊過程中符合晶片的溫度曲線要求。
- 磁控開關可以和腳踏開關相互配合使用，操作簡單。具有密碼鎖定保護功能。
- 感測器閉環迴路，微電腦過零觸發控溫，功率大，升溫迅速，不受出風量影響，溫度調節方便且精確穩定。
- 採用無碳刷渦流風機，可調整氣流量輸出，配置真空吸筆，適合多種用途。
- 系統設有自動吹送冷風功能，可延長發熱器使用壽命，保護熱風塑料握柄。

- 按 VACUUM 鍵，立即啟動真空吸筆，吸取 BGA 元件。配置 BGA 熱風頭 ×1 只。
- 可另選購 PCB 板固定架及熱風握柄升降台、IR 熱輻射預熱台，作業更便捷。
- ESD 防靜電設計。

規 格

型號	BGA500P
輸入電壓 50~60Hz	區分 AC110V/AC220V
功率	1300W
溫度設定範圍	100°C ~ 500°C
工作時間設定範圍	000~999 秒 (--- 表示不受工作時間控制一直工作)
風量設定範圍	6~200
最大風量	200L/min
尺寸	250(L)×230(W)×150(H)mm
重量	4.5kg